Особенности формирования островков Ge(Si) на релаксированных буферных слоях Si_{1-x}Ge_x/Si (001)

© Н.В. Востоков, Ю.Н. Дроздов, З.Ф. Красильник, О.А. Кузнецов*, Д.Н Лобанов, А.В. Новиков, М.В. Шалеев[¶]

Институт физики микроструктур Российской академии наук, 603950 Нижний Новгород, Россия * Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 603950 Нижний Новгород, Россия

(Получена 31 мая 2005 г. Принята к печати 14 июня 2005 г.)

Представлены результаты исследования роста самоформирующихся островков Ge(Si), выращенных на релаксированных буферных слоях Si_{1-x}Ge_x/Si (001) ($x \approx 25\%$) с малой шероховатостью поверхности. Показано, что рост самоформирующихся островков на буферных слоях SiGe качественно аналогичен росту островков на Si (001). Обнаружено, что изменение морфологии поверхности (переход от *dome-* к *hut*-островкам) в случае роста островков на релаксированных буферных слоях SiGe происходит при большей температуре, чем для островков Ge(Si)/Si (001). Причинами этого могут быть как меньшее рассогласование кристаллических решеток островка и буферного слоя, так и несколько бо́льшая поверхностная плотность островков при их росте на буфере SiGe.

PACS: 68.65.Hb, 68.55.Ac, 68.55.Jk

1. Введение

В настоящее время одним из направлений дальнейшего развития кремниевой микроэлектроники является использование гетероструктур Ge/Si для улучшения параметров уже существующих электронных приборов и создания новых оптоэлектронных приборов [1]. За счет применения напряженных слоев GeSi в качестве базы биполярного транзистора удалось значительно повысить его быстродействие и в результате наладить коммерческое производство интегральных схем на основе кремния с рабочей частотой выше 100 ГГц [2]. В последнее время значительные успехи в увеличении быстродействия полевых транзисторов достигнуты за счет использования в качестве "искусственных" подложек релаксированных буферных слоев $Si_{1-x}Ge_x$, сформированных на подложках Si (001). Рост напряженных слоев Si и Ge на релаксированных буферных слоях $Si_{1-x}Ge_x/Si(001)$ позволяет увеличить быстродействие полевых транзисторов как с *n*-, так и с *p*-каналом [3]. С использованием релаксированных буферных слоев $Si_{1-x}Ge_x/Si(001)$ в качестве подложек для роста сверхрешеток GeSi/Si связываются надежды на создание каскадных лазеров терагерцового диапазона [4].

Еще одним классом GeSi-структур, перспективным с точки зрения создания оптоэлектронных приборов, являются структуры с самоформирующимися островками Ge(Si). Исследуется возможность создания на основе этих структур эффективных светоизлучающих и фотоприемных устройств ближнего инфракрасного диапазона, в том числе для рабочего диапазона длин волн оптоволоконных линий связи (1.3 и 1.55 мкм) [5]. К настоящему времени достаточно хорошо изучены структурные и оптические свойства самоформирующихся островков Ge(Si), выращенных на подложках Si (001) [6,7]. В то же время рост самоформирующихся островков Ge(Si) на релаксированных буферных слоях $Si_{1-x}Ge_x/Si(001)$ может дать ряд преимуществ. Так, в ряде работ рассматривалась возможность формирования пространственно упорядоченного массива островков Ge(Si) за счет их роста на релаксированных буферных слоях $Si_{1-x}Ge_x/Si(001)$, поверхность которых изначально (до формировния островков) имела хорошо выраженный рельеф, обусловленный наличием дислокаций несоответствия (так называемая cross-hatch картина) [8,9]. Кроме этого, за счет роста островков Ge(Si) на релаксированных буферных слоях $Si_{1-x}Ge_x/Si(001)$ может быть решена проблема слабой пространственной локализации электронов в структурах с островками, которая является одной из причин довольно низкой эффективности излучательной рекомбинации в гетероструктурах в GeSi/Si (001) с самоформирующимися наноостровками и квантовыми точками [10]. Эффективная локализация электронов вблизи островков может быть достигнута за счет их встраивания в напряженный (растянутый) слой Si, который может быть сформирован на релаксированном буферном слое $Si_{1-r}Ge_r/Si(001)$.

Известно, что в случае роста самоформирующихся островков Ge(Si) на подложках Si (001) (далее островков Ge(Si)/Si (001)) положение, интенсивность и ширина пика фотолюминесценции, связанного с островками, зависят от их размеров, формы и поверхностной плотности. Очевидно, что изменение постоянной кристаллической решетки подложки при переходе от роста на подложке Si (001) к росту островков на релаксированном буферном слое Si_{1-x}Ge_x/Si (001) приведет к существеному изменению параметров островков, что в свою очередь должно отразиться на оптических свойствах этих структур.

[¶] E-mail: shaleev@ipm.sci-nnov.ru

В данной работе представлены результаты исследования особенностей роста самоформирующихся островков Ge(Si) на релаксированных буферных слоях Si_{1-x}Ge_x/Si (001) ($x \approx 25\%$) (далее островков Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x). Исследована зависимость размеров, формы и поверхностной плотности островков от температуры осаждения Ge (T_g) в интервале $T_g = 550-750$ °C. Особое внимание уделено изменению типа островков Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x, происходящему в диапазоне $T_g = 600-630$ °C.

2. Методика эксперимента

В настоящей работе в качестве подложек использовались структуры с градиентными релаксированными буферными слоями Si_{1-x}Ge_x, выращенными на подложках Si (001) методом гидридной газофазной эпитаксии (ГФЭ) при атмосферном давлении с использованием германия (GeH₄) и силана (SiH₄) [11]. С целью уменьшения шероховатости поверхности выращенные буферные слои Si_{1-x}Ge_x/Si (001) подвергались химико-механическому полированию (ХМП) [12] с использованием специального раствора, состоящего из перекиси водорода, глицерина и аэросила [13].

Рост структур с самоформирующимися островками Ge(Si) релаксированных буферных на слоях $Si_{1-x}Ge_x/Si(001)$ был выполнен методом молекулярнопучковой эпитаксии (МПЭ) из твердых источников. Для роста использовались буферные слои $Si_{1-x}Ge_x/Si(001)$ с максимальным содержанием Ge $x \approx 25\%$, подвергнутые ХМП. Испарение Ge и Si в установке МПЭ осуществлялось при помощи электронно-лучевых испарителей. роста структур лежали в диапазоне Скорости 0.01-0.1 нм/с. Рост структур на релаксированных слоях $Si_{1-x}Ge_x/Si(001)$ начинался с осаждения буферного слоя $Si_{1-x}Ge_x$ с содержанием Ge, соответствующим содержанию Ge в верхнем ненапряженном слое релаксированного буфера. Далее осаждался слой Si с эквивалентной толщиной ~ 2 нм, на котором формировались островки Ge(Si). Островки были получены за счет осаждения Ge с эквивалентной толщиной $d_{Ge} = 7-8$ монослоев (MC) $(1 \text{ MC} \approx 0.14 \text{ нм})$. Температура осаждения Ge варьировалась в диапазоне $T_g = 550 - 750^{\circ}$ С.

Плотность прорастающих дислокаций в выращенных структурах определялась с помощью селективного травления. Рентгенодифракционные исследования выращенных структур выполнены на двухкристальном дифрактометре ДРОН-4. Исследования морфологии поверхности структур были выполнены методом атомно-силовой микроскопии (ACM) на микроскопе Solver PRO с использованием бесконтактной моды.

3. Результаты и их обсуждение

По данным селективного травления плотность прорастающих дислокаций в полученных релаксированных буферных слоях Si_{1-x}Ge_x/Si (001) с максимальным со-



Рис. 1. АСМ-снимок поверхности релаксированного буферного слоя $Si_{1-x}Ge_x/Si(001)$ (x = 25%), выращенного методом ГФЭ и подвергшегося ХМП. Размер поля изображения $10 \times 10 \text{ мкm}^2$.

держанием Ge $x \approx 25\%$ была на уровне $\sim 2 \cdot 10^4 \,\mathrm{cm}^{-2}$. Проведенные АСМ-исследования показали (рис. 1), что ХМП позволяет полностью удалить с поверхности буферных слоев неровности, связанные с сеткой дислокаций несоответствия. В результате проведения ХМП шероховатость поверхности буферных слоев с максимальной долей Ge $x \approx 25\%$ уменьшается примерно на порядок (среднеквадратичная шероховатость поверхности < 0.5 нм), но остается несколько выше шероховатости исходных подложек Si (001) (среднеквадратичная шероховатость поверхности < 2 нм) [11]. Исследования поверхности тестовых структур с ненапряженным буферным слоем $Si_{1-x}Ge_x$, выращенным МПЭ на релаксированных слоях $Si_{1-x}Ge_x/Si(001)$, показали, что используемые в методе МПЭ температуры (≤ 800°С) не приводят к повторному возникновению на поверхности структур неровностей, связанных с сеткой дислокаций несоответствия.

Было обнаружено, что во всем используемом интервале температур роста осаждение слоя Ge толщиной 7–8 MC на релаксированный буферный слой Si_{1-x}Ge_x/Si (001) с максимальным содержанием Ge $x \approx 25\%$ приводит к формированию островков (рис. 2). Необходимо отметить, что в исследуемых структурах не наблюдалось пространственного упорядочения самоформирующихся островков Ge(Si), что связывается с отсутствием на поверхности буферных слоев Si_{1-x}Ge_x/Si (001), подвергнутых XMП, сетки неровностей, обусловленных с дислокациями несоответствия.

Согласно АСМ-данным в интервале температур осаждения Ge $T_g = 630-750^{\circ}$ C на поверхности наблюдаются два типа островков Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x: пирамидальные (*pyramid*) и куполообразные (*dome*) островки (рис. 2, *a*, *b*). Как и в случае формирования островков Ge(Si)/Si (001), при уменьшении температуры осаждения Ge происходит уменьшение размеров островков $Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x$ и растет их поверхностная плотность (рис. 3).

При уменьшении температуры осаждения Ge с 630 до 600°C происходит резкое изменение морфологии поверхности структур с островками — на поверхности



Рис. 2. АСМ-снимки поверхности структур с самоформирующимися островками $Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x$, выращенными при температурах осаждения Ge 650 (*a*), 630 (*b*) и 600°C (*c*). Размер поля изображения $1 \times 1 \text{ мкm}^2$.



Рис. 3. Зависимости высоты (a) и поверхностной плотности (b) островков Ge(Si)/Si (001) и Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x от температуры осаждения Ge. Пунктирной линией показано изменение параметров при смене типа островков.

структур, выращенных при температурах $T_g \leq 600^{\circ}$ С, наблюдаются лишь пирамидальные и так называемые *hut*-островки (рис. 2, *c*), имеющие прямоугольное основание и вытянутую пирамидальную форму. Большие куполообразные *dome*-островки при $T_g \leq 600^{\circ}$ С отсутствуют. Изменение морфологии поверхности заключается не только в изменении формы островков, но и в существенном уменьшении средней высоты островков (рис. 3, *a*). Аналогичное изменение морфологии поверхности островков случае роста островков Ge(Si)/Si (001) [14,15]. Однако для самоформирующихся островков Ge(Si)/Si (001) данный переход имел место в диапазоне температур осаждения Ge $T_g = 550-600^{\circ}$ С.

Как было показано в [16], образование *hut*-островков при низких температурах осаждения Ge может быть обусловлено изменением диффузии и энергетических потенциалов для образования новых граней островков. В этом случае разница в температурах изменения морфологии островков в случае роста островков Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x и Ge(Si)/Si (001) может быть связана

с различием коэффициентов диффузии атомов на поверхности буферных слоев $Si_{1-x}Ge_x$ и Si (001), а также с различием энергетических потенциалов образования новых граней островков.

Еще одной возможной причиной изменения морфологии поверхности может являться увеличение поверхностной плотности самоформирующихся островков $Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x$ (рис. 3, b) при понижении температуры осаждения Ge. Известно [17], что для образования domeостровков необходимо, чтобы pyramid-островки достигли некоторого критического объема, который зависит от рассогласования кристаллических решеток островка и подложки. При высокой поверхностной плотности изза взаимодействия с соседними островками pyramidостровки, первоначально образующиеся на поверхности структур, могут не достигать равновесного критического объема, необходимого для их трансформации в островки типа dome. Ранее было показано [18], что при высокой температуре роста это может привести к уменьшению критического объема *ругатіd*-островков. Однако кинетические ограничения, связанные с низкими температурами роста, могут препятствовать переходу pyramid-островков в dome-островки при объемах, меньших равновесного критического объема. В этом случае рост pyramid-островков, не достигших из-за упругого взаимодействия с соседними островками равновесного критического объема, может происходить за счет увеличения их латерального размера в направлении наименьшего взаимодействия с соседними островками. В этом случае произойдет трансформация pyramid-островков в островки типа hut.

Анализ АСМ-снимков структур с островками $Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x$ и Ge(Si)/Si(001), сформированными при $T_g = 600 - 650^{\circ}$ С, показал, что в этой области температур поверхностная плотность островков $Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x$ несколько выше поверхностной плотности островков Ge(Si)/Si(001) (рис. 3, b). Увеличение поверхностной плотности островков $Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x$ приводит к тому, что упругие взаимодействия между pyramid-островками становятся существенными при более высоких температурах роста, в результате чего и происходит смещение точки изменения морфологии островков Ge(Si)/Si1-xGex в область более высоких температур. Рост поверхностной плотности островков при росте на буферных слоях $Si_{1-x}Ge_x/Si(001)$ может быть связан с отмеченной выше большей шероховатостью поверхности буферных слоев по сравнению с исходными подложками Si (001).

Еще одной возможной причиной увеличения температуры перехода *dome-hut* для островков Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x может являться меньшее рассогласование кристаллических решеток островка Ge(Si) и релаксированного буферного слоя Si_{1-x}Ge_x, чем в случае роста островков Ge(Si)/Si (001) при той же температуре осаждения Ge. Рентгенодифракционные исследования структур с самоформирующимися островками Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x, выращенными при $T_g = 630$ °C, показали, что среднее содержание Ge в островках оказывается на 10–12% выше содержания Ge в островках Ge(Si)/Si (001), сформированных при той же температуре. Однако, с учетом 25%-го содержания Ge в буферном слое SiGe, рассогласование кристаллических решеток буферного слоя SiGe и островков $Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x$, сформированных на нем, оказывается меньшим, чем для островков Ge(Si)/Si (001). От рассогласования кристаллических решеток островка и подложки существенно зависит критический объем *ругатіd*-островков [17,19]. Меньшее рассогласование кристаллических решеток островка и подложки в случае осаждения Ge на релаксированный буферный слой Si_{1-r}Ge_r/Si (001) приводит к увеличению критического размера *ругатід*-островков. Следовательно, уже при меньшей поверхностной плотности (при более высоких температурах роста) взаимодействие между близлежащими pyramid-островками становится существенным, препятствуя переходу pyramid-островков в dome-островки и приводя к появлению на поверхности *hut*-островков.

4. Заключение

В работе исследован рост самоформирующихся островков Ge(Si) на релаксированных буферных слоях $Si_{1-x}Ge_x/Si(001)$ ($x \approx 25\%$) с малой шероховатостью поверхности. Показано, что качественно рост островков Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x аналогичен росту островков Ge(Si)/Si (001). Обнаружено, что резкое изменение морфологии поверхности (переход от *dome-* к *hut*островкам) в случае роста островков Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x происходит при более высоких температурах роста по сравнению с ростом островков Ge(Si)/Si (001). Данное изменение связывается как с меньшим рассогласованием кристаллических решеток островка Ge(Si)/Si_{1-x}Ge_x и релаксированного буферного слоя, так и с несколько большей поверхностной плотностью островков в случае роста их на релаксированных буферных слоях Si_{1-x}Ge_x.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-02-17336-а), программы BRHE (проект Y1 P-01-05) и программ Российской академии наук.

Список литературы

- [1] D.J. Paul. Semicond. Sci. Technol., 19, R75 (2004).
- [2] H.G. Grimmeiss. ΦΤΠ, **33** (9), 1032 (1999).
- [3] F. Schaffler. Semicond. Sci. Technol., 12, 1515 (1997).
- [4] L. Diehl, S. Mentese, E. Muller, D. Grutzmacher, H. Sigg, U. Gennser, I. Sagnes, Y. Campidelli, O. Kermarrec, D. Bensahel, J. Faist. Appl. Phys. Lett., 81, 4700 (2000).
- [5] А.И. Якимов, А.В. Двуреченский, В.В. Кириенко, А.И. Никифоров. ФТТ, 47 (1), 37 (2005).
- [6] K. Brunner. Rep. Progr. Phys., 65, 27 (2002).
- [7] J. Stangl, V. Holỳ, G. Bauer. Rev. Mod. Phys., 76, 725 (2004).
- [8] J.L. Liu, S. Tong, Y.H. Luo, J. Wan, K.L. Wang. Appl. Phys. Lett., 79, 3431 (2001).
- [9] M.A. Lutz, R.M. Feenstra, F.K. LeGoues, P.M. Money, J.O. Chu. Appl. Phys. Lett., 66, 724 (1995).

- [10] A.I. Yakimov, N.P. Stepina, A.V. Dvurechenskii, A.I. Nikiforov, A.V. Nenashev. Semicond. Sci. Technol., 15, 1125 (2000).
- [11] Н.В. Востоков, Ю.Н. Дроздов, О.А. Кузнецов, З.Ф. Красильник, А.В. Новиков, В.А. Перевозщиков, М.В. Шалеев. ФТТ, 47 (1), 44 (2005).
- [12] K. Sawano, K. Kawaguchi, T. Ueno, S. Koh, K. Nakagawa, Y. Shiraki. Mater. Sci. Eng. B, 89, 406 (2002).
- [13] В.А. Перевощиков, В.Д. Скупов. Особенности абразивной и химической обработки поверхности полупроводников (Н. Новгород, Изд-во ННГУ, 1992) с. 198.
- [14] O.G. Schmidt, C. Lange, K. Eberl. Phys. Status Solidi B, 215, 319 (1999).
- [15] Н.В. Востоков, З.Ф. Красильник, Д.Н. Лобанов, А.В. Новиков, М.В. Шалеев, А.Н. Яблонский. ФТТ, 46 (1), 63 (2004).
- [16] M. Kästner, B. Voigtländer. Phys. Rev. Lett., 82, 2745 (1999).
- [17] F.M. Ross, J. Tersoff, R.M. Tromp. Phys. Rev. Lett., 80, 984 (1998).
- [18] J.A. Floro, G.A. Lucadamo, E. Chason, L.B. Freund, M. Sinclair, R.D. Twesten, R.Q. Hwang. Phys. Rev. Lett., 80, 4717 (1998).
- [19] Н.В. Востоков, Ю.Н. Дроздов, З.Ф. Красильник, Д.Н. Лобанов, А.В. Новиков, А.Н. Яблонский. Письма ЖЭТФ, 76, 365 (2002).

Редактор Л.В. Шаронова

Peculiarities of Ge(Si) islands formation upon Si_{1-x}Ge_x/Si (001) relaxed buffer layers

N.V. Vostokov, Yu.N. Drozdov, Z.F. Krasil'nik,

O.A. Kuznetsov*, D.N. Lobanov, A.V. Novikov, M.V. Shaleev

Institute for Physics of Microstructures, Russian Academy of Sciences, 603950, GSP-105, Nizhny Novgorod, Russia * Physico-Technical Research Institute of N.I. Lobachevsky Nizhniy Novgorod State University, 603950 Nizhny Novgorod, Russia